

東京エレクトロン

2008年3月期 決算説明会

2008年5月13日

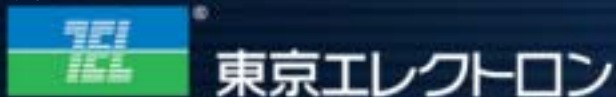
資料取扱い上の注意

将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体／FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は円単位で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2008年3月期 決算概要

経理部 部長 佐伯 幸雄

2008年5月13日

2008年3月期業績

(単位:億円)

▶▶ 売上・利益ともに過去最高を更新

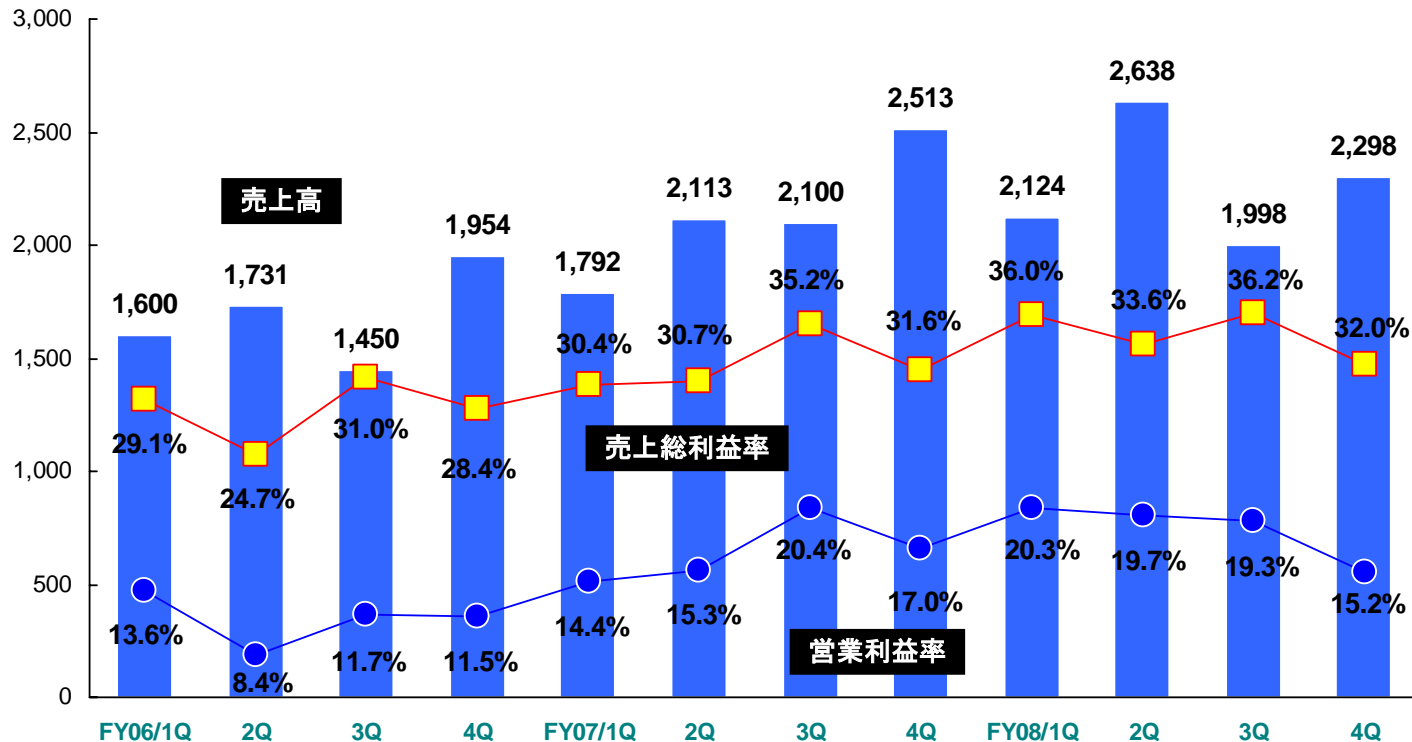
	2007年3月期	2008年3月期	対前年増減額	対前年増減率
売上高	8,519	9,060	541	+6.4%
SPE	6,426	7,264	838	+13.0%
FPD	1,007	680	-327	-32.5%
EC/CN	1,074	1,111	37	+3.5%
その他	11	4	-6	-59.4%
売上総利益	2,726 (32.0%)	3,112 (34.4%)	386	+14.2%
販管費	1,286	1,427	141	+11.0%
営業利益	1,439 (16.9%)	1,684 (18.6%)	245	+17.0%
経常利益	1,439	1,727	287	+20.0%
税前利益	1,444	1,692	248	+17.2%
当期純利益	912	1,062	150	+16.4%
研究開発費	569	660	91	+16.0%
設備投資額	271	227	-44	-16.3%
減価償却実施額	188	214	25	+13.8%

SPE: 半導体製造装置, FPD: FPD製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク



売上・利益率推移

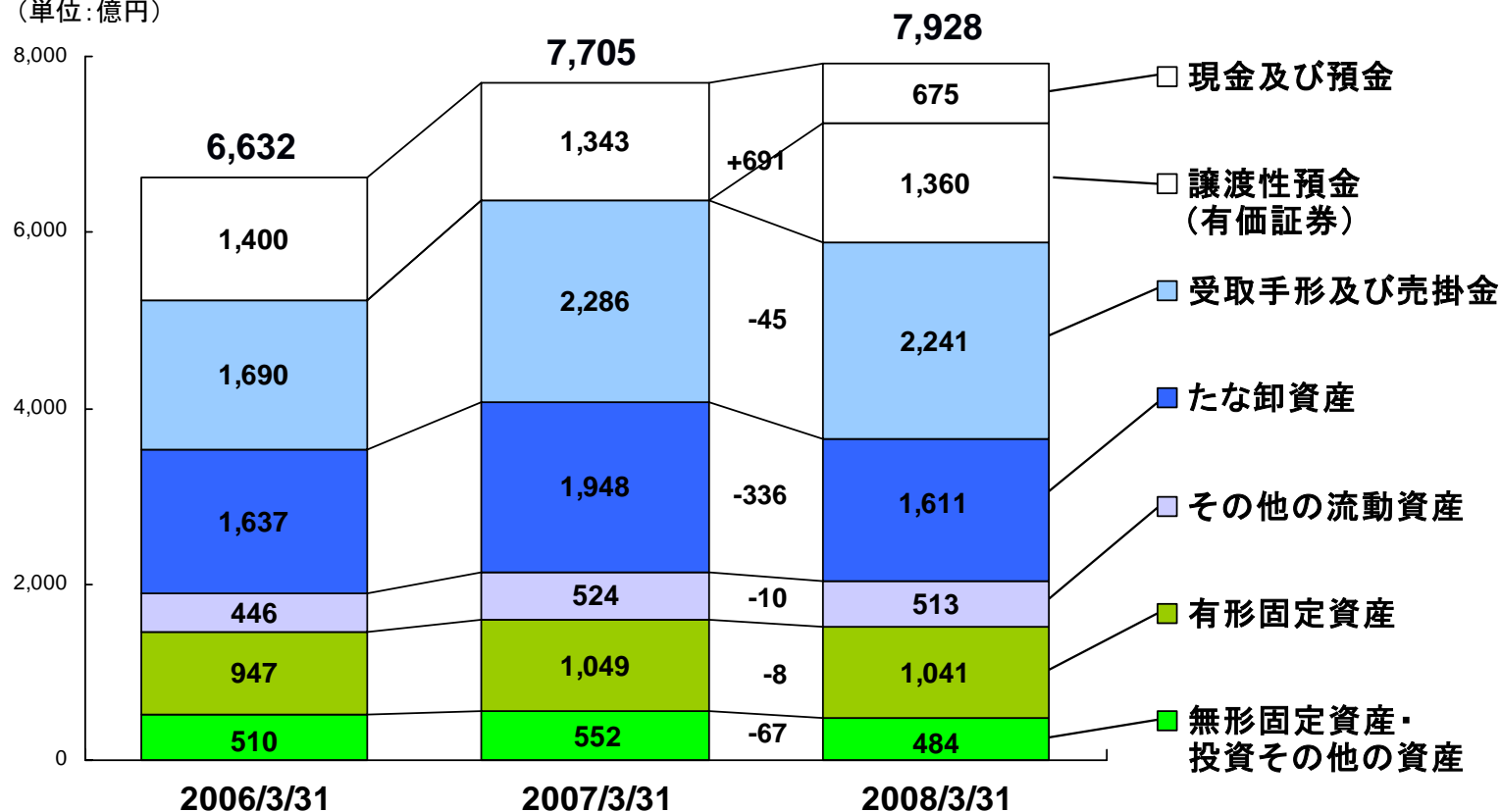
(単位:億円)



資産



(単位: 億円)



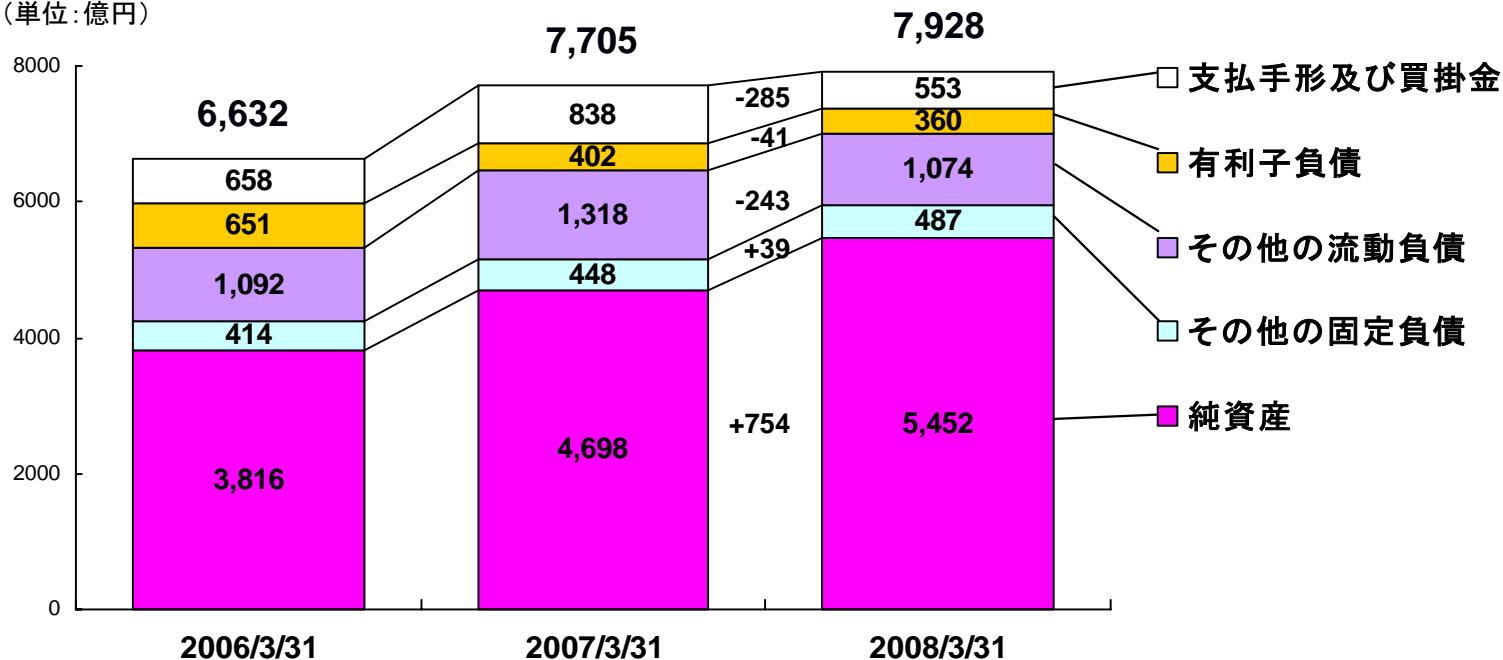
*従来、「現金及び預金」に含まれていた「譲渡性預金」は、2008/3/31より区分して表示しております。



負債・純資産



(単位: 億円)



有利子負債/自己資本

17.3 %

8.7%

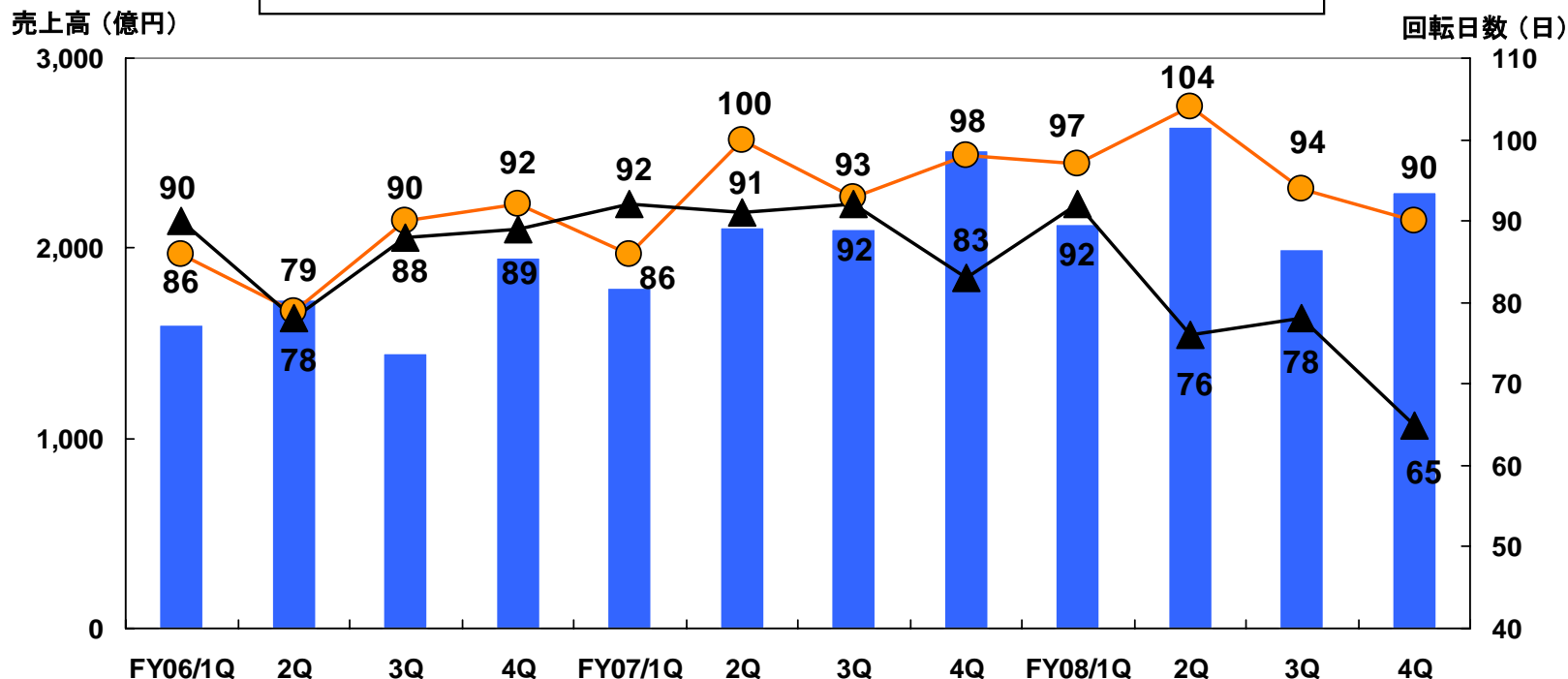
6.7%

* 2007/3/31, 2008/3/31: 自己資本=純資産-(新株予約権+少数株主持分)

* 2006/3/31: 純資産には少数株主持分が含まれております。



たな卸資産・売上債権の回転日数



*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

* FY2006/1Qの回転日数算出に使用したFY2005/2Q売上高 = 新会計方針によるFY2005/1Hの売上高 ÷ 2



キャッシュ・フロー

(単位:億円)



	2006/3	2007/3	2008/3
営業活動により調達(▲:使用)したキャッシュ	788	542	1,169
税金等調整前当期純利益	753	1,444	1,692
減価償却費	191	188	214
仕入債務、売上債権、棚卸資産の増減	64	▲727	34
その他	▲220	▲362	▲771
投資活動により調達(▲:使用)したキャッシュ	▲105	▲252	▲301
設備投資等	▲105	▲264	▲190
その他	0	11	▲110
財務活動により調達(▲:使用)したキャッシュ	▲434	▲347	▲270
有利子負債の増加(▲:減少)	▲344	▲249	▲41
配当金	▲97	▲128	▲234
その他	8	30	5
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲3	0	▲6
現金及び現金同等物の増加額(▲:減少)	245	▲56	591
現金及び現金同等物の期首残高	1,154	1,400	1,343
現金及び現金同等物の期末残高	1,400	1,343	1,934

フリーキャッシュフローが867億円のプラスとなる



2008年3月期 決算(連結)

事業の種類別セグメント情報

営業利益・営業利益率

産業用電子機器

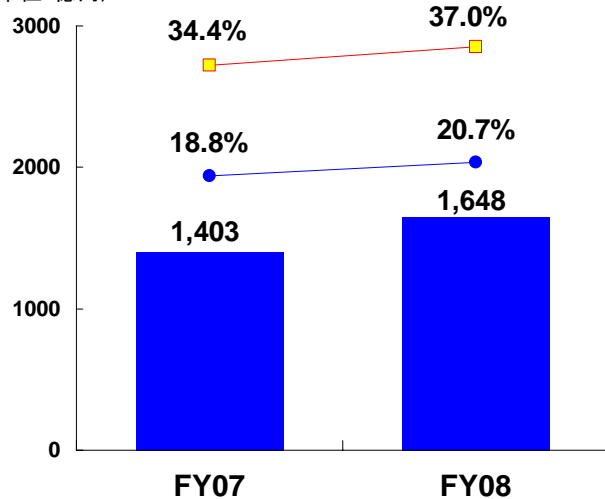
(半導体製造装置、FPD製造装置、その他)

電子部品・情報通信機器

(半導体製品、コンピュータ・ネットワーク機器、ミドルウェア・ソフトウェア、その他電子部品等)

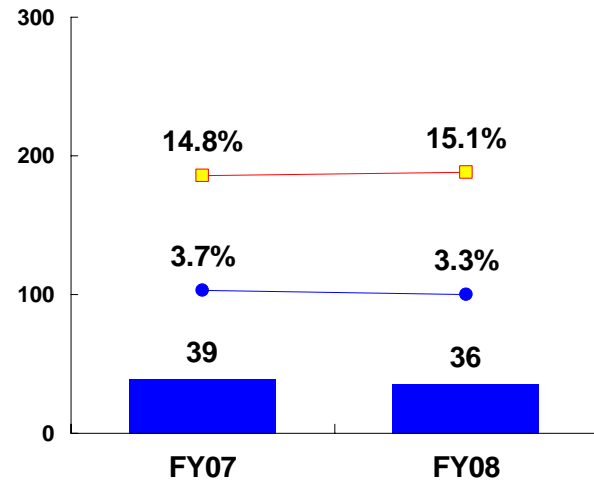
- 「コンピュータ・ネットワーク」につきましては、2007年3月期よりセグメント区分を「電子部品・情報通信機器」に変更しております。

(単位:億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

(単位:億円)

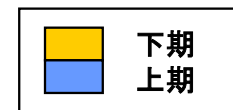


■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

- セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



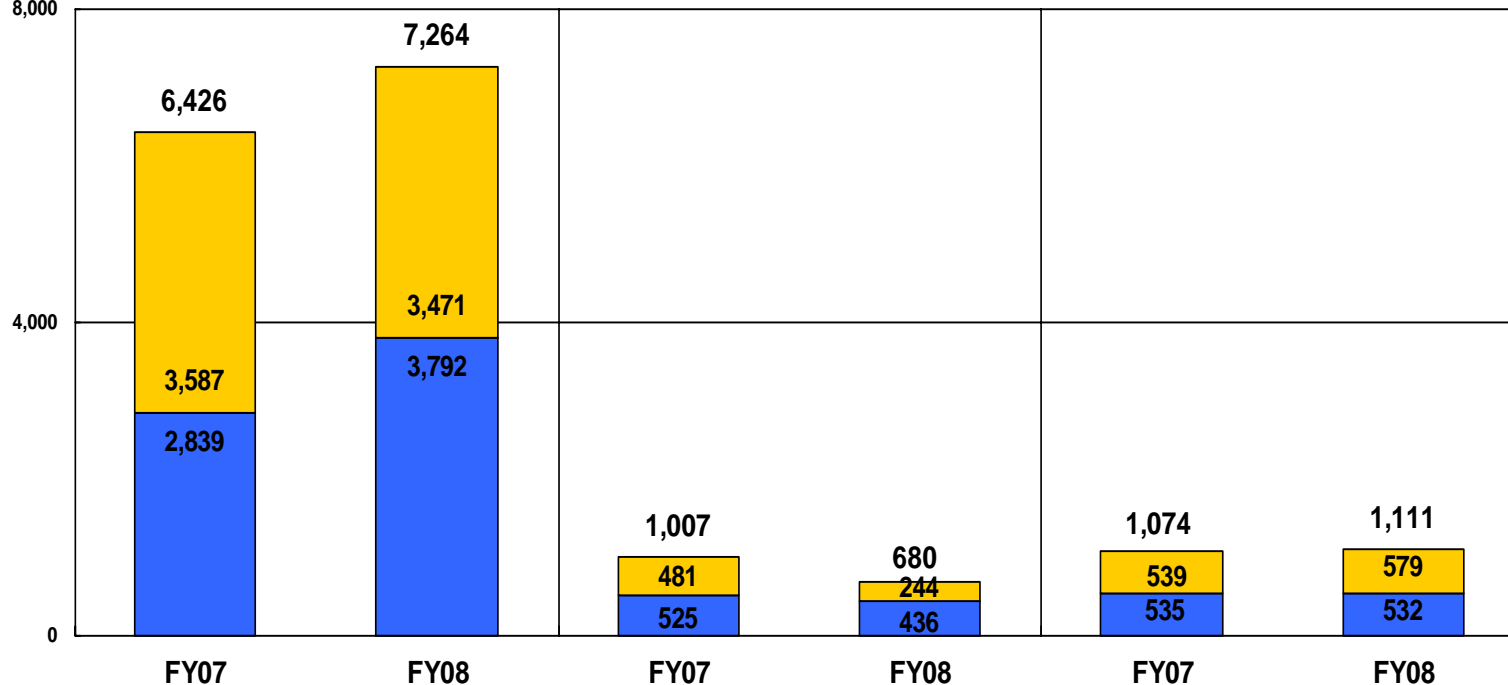
2008年3月期 決算(連結) 部門別売上高



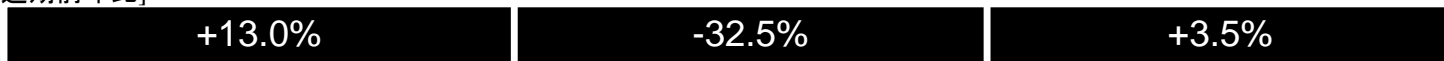
SPE部門 (半導体製造装置)	FPD部門 (フラットパネルディスプレイ製造装置)	EC/CN部門 (電子部品/コンピュータ・ネットワーク)
--------------------	------------------------------	---------------------------------

(単位: 億円)
8,000

これら3部門の売上以外に「その他」の売上があります。



[通期前年比]

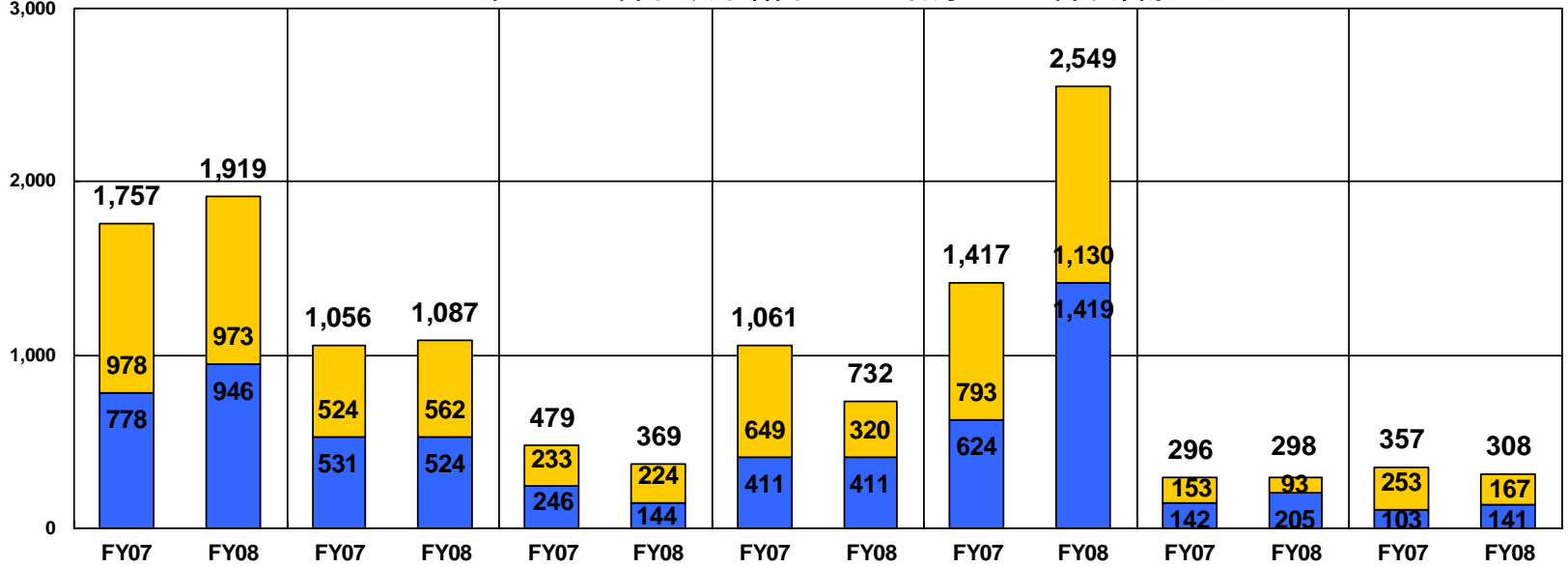


2008年3月期 決算(連結) SPE部門地域別売上高



2007/3 6,426億円
2008/3 7,264億円

(単位:億円)
3,000

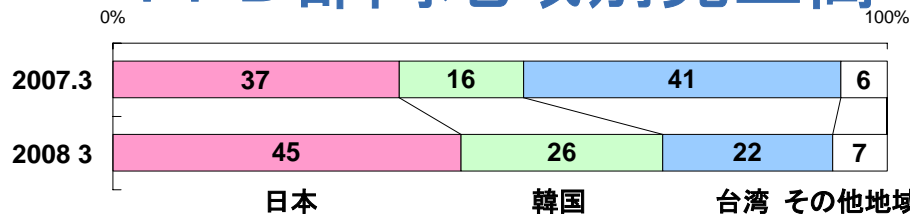
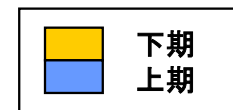


[通期前年比]

地域	日本	米国	欧州	韓国	台湾	中国	東南アジア
前年比	+9.2%	+2.9%	-23.0%	-31.0%	+79.8%	+0.7%	-13.7%

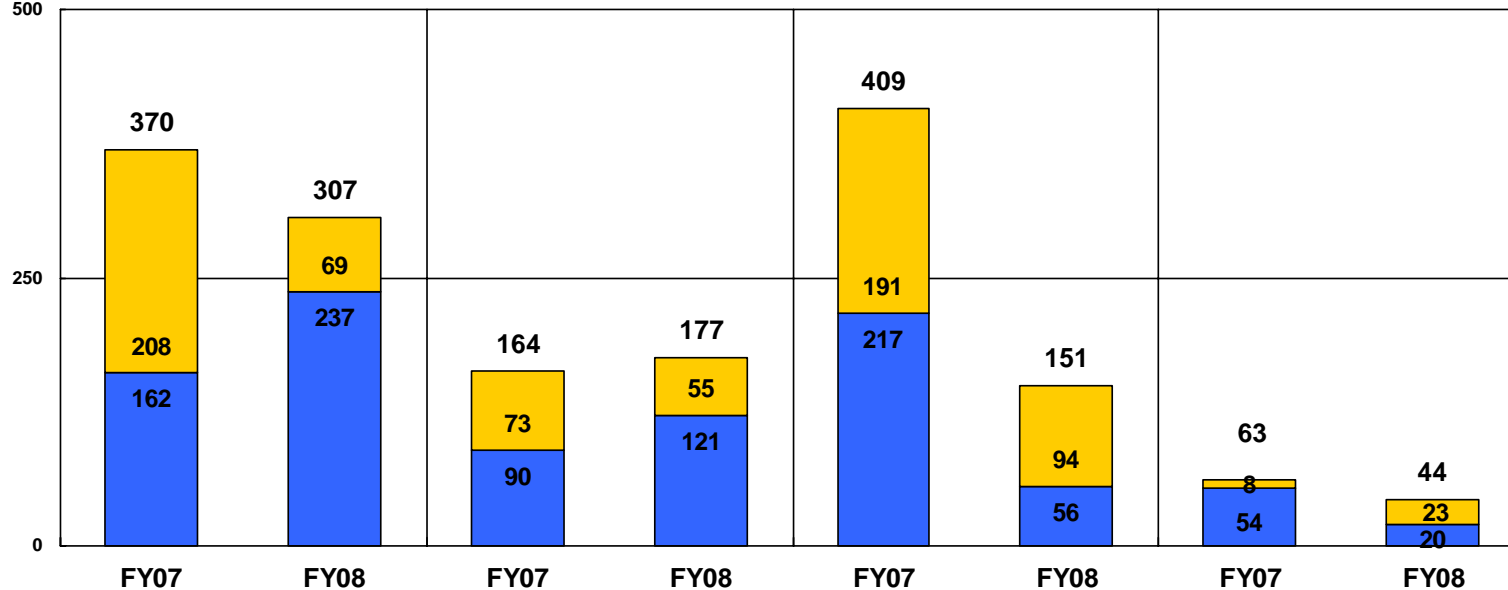


FPD部門地域別売上高



2007/3 1,007億円
2008/3 680億円

(単位: 億円)
500



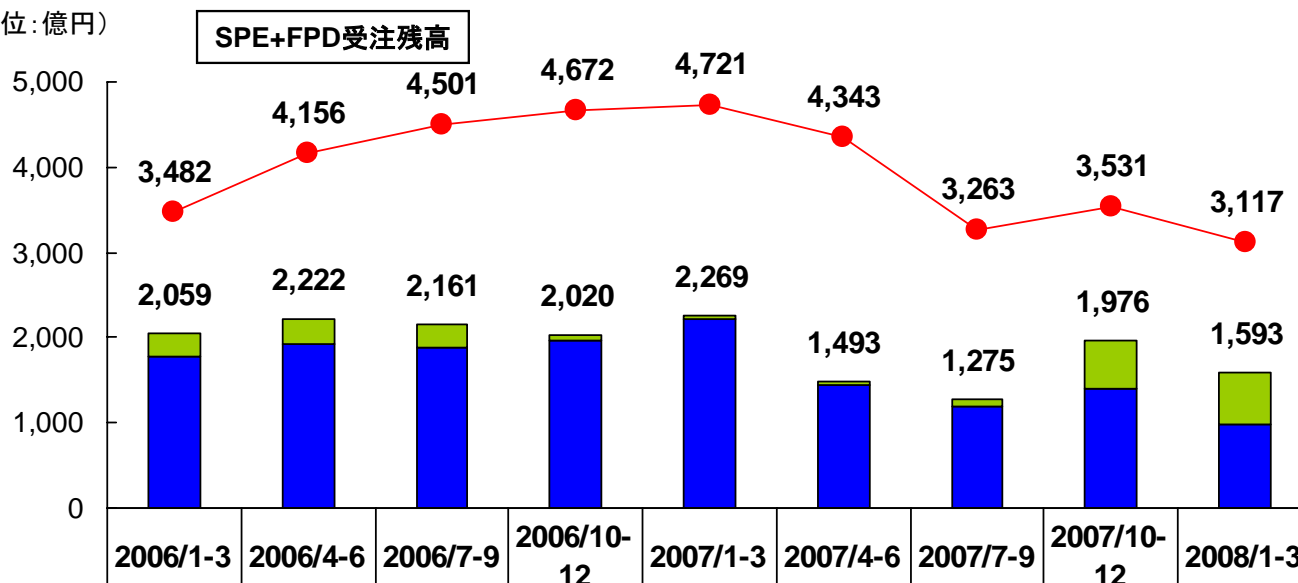
[通期前年比]

日本	韓国	台湾	その他地域
-17.1%	7.7%	-63.1%	-29.4%



SPE+FPD受注額, 受注残高

(単位: 億円)



FPD製造装置 受注額	277	296	275	55	42	41	73	573	610
半導体製造装置 受注額	1,782	1,926	1,886	1,964	2,227	1,452	1,202	1,403	983
受注額合計	2,059	2,222	2,161	2,020	2,269	1,493	1,275	1,976	1,593
受注残高	3,482	4,156	4,501	4,672	4,721	4,343	3,263	3,531	3,117

受注残高内訳

FPD	990	997	1,036	831	652	479	331	803	1,271
SPE	2,491	3,158	3,464	3,841	4,069	3,864	2,931	2,727	1,846



四半期決算の推移



四半期業績推移

(単位:億円)

	2008年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	合計
売上高	2,124	2,638	1,998	2,298	9,060
売上総利益	765	887	724	735	3,112
販売費及び一般管理費	335	368	339	385	1,427
営業利益	430	519	384	349	1,684
経常利益	411	546	397	371	1,727
税前利益	424	557	400	310	1,692
当期純利益	261	362	256	182	1,062

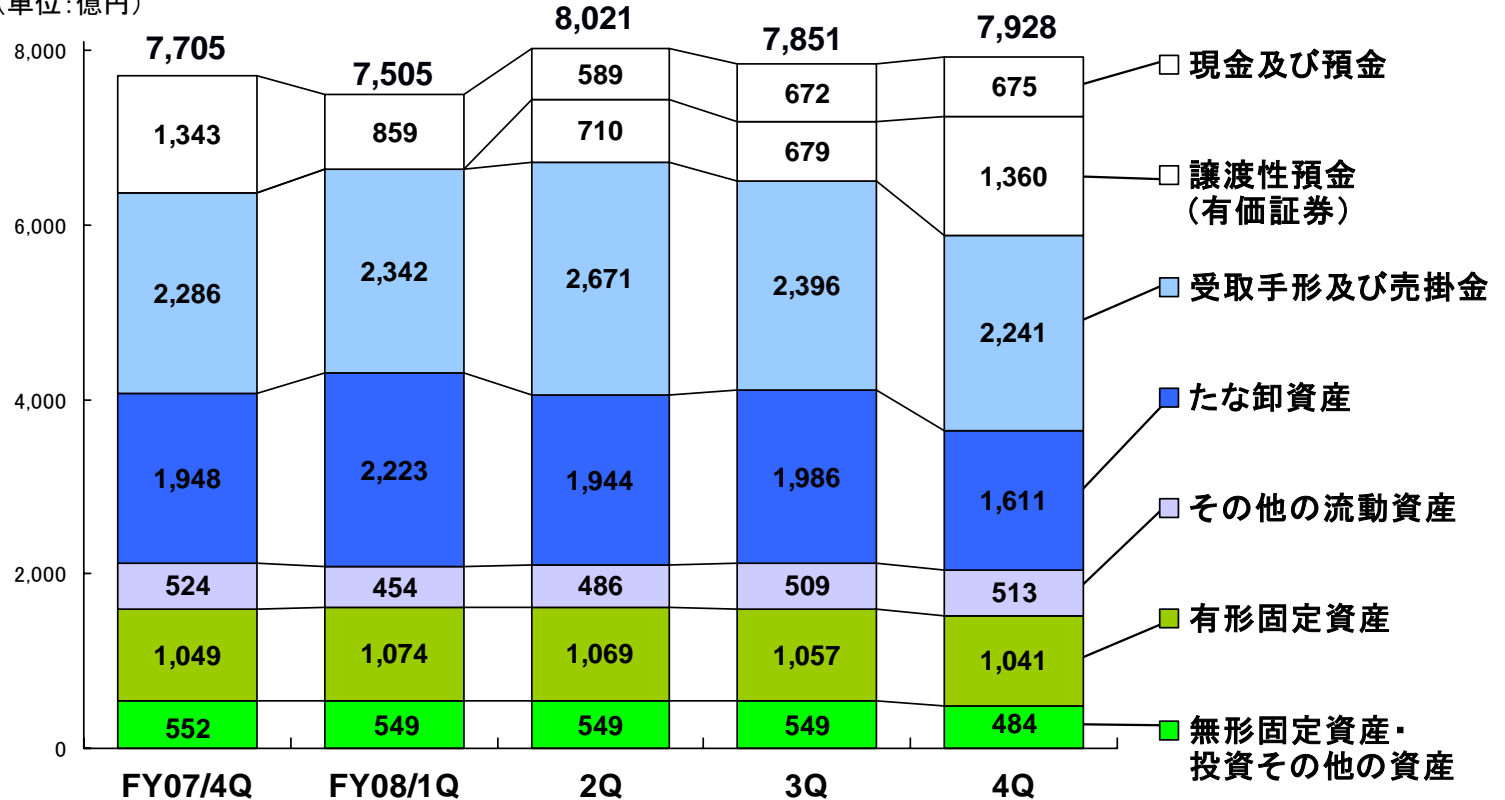
研究開発費	148	170	159	182	660
設備投資額	70	57	41	57	227
減価償却実施額	46	51	55	60	214



2008年3月期 決算(連結)

資産

(単位: 億円)

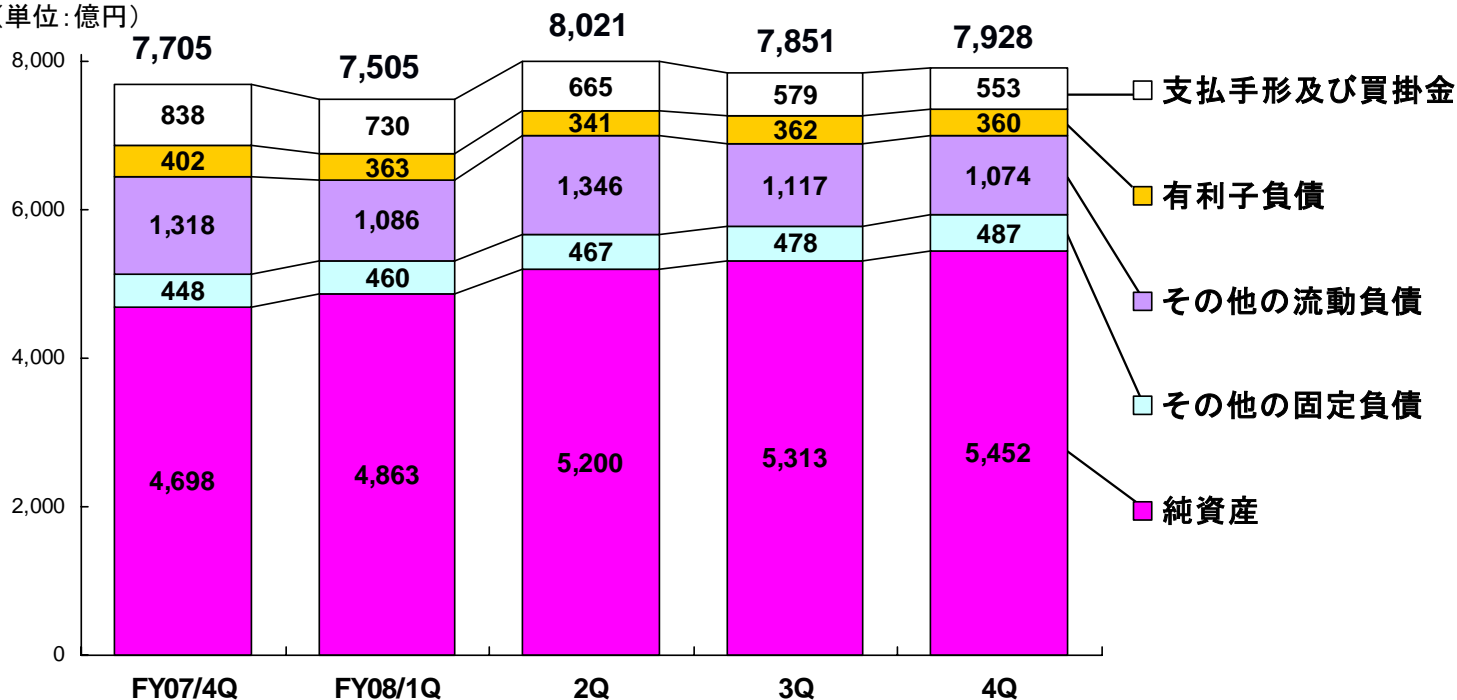


*従来、「現金及び預金」に含まれていた「譲渡性預金」は、FY08/2Qより区分して表示しております。



負債・純資産

(単位: 億円)



有利子負債/自己資本

8.7%	7.6%	6.7%	7.0%	6.7%
------	------	------	------	------

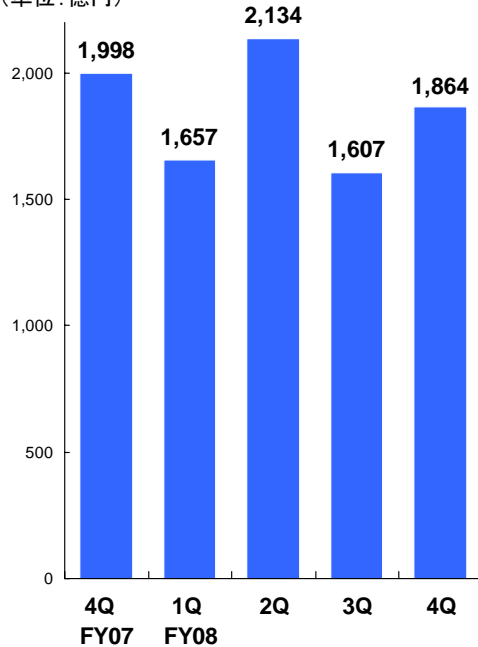
* 自己資本 = 純資産 - (新株予約権 + 少数株主持分)



部門別売上高

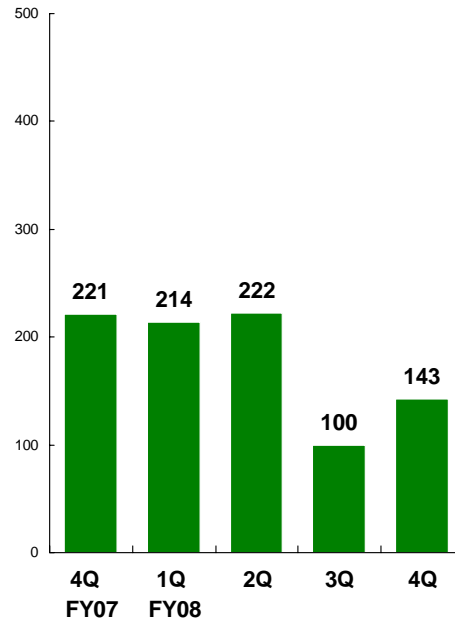
SPE部門 (半導体製造装置)

(単位:億円)



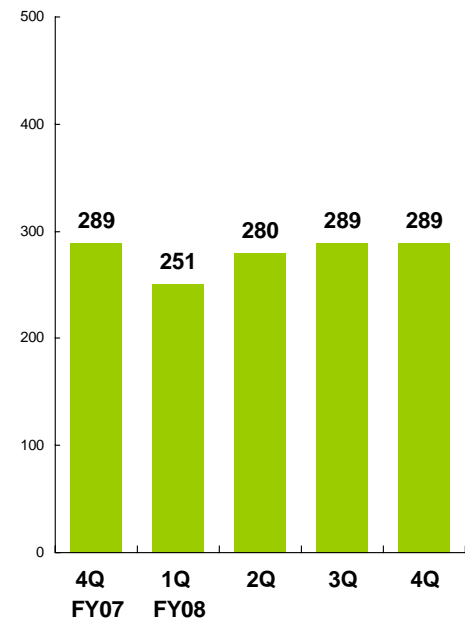
FPD部門 (フラットパネルディスプレイ製造装置)

(単位:億円)



EC/CN部門 (電子部品/コンピュータ・ネットワーク)

(単位:億円)



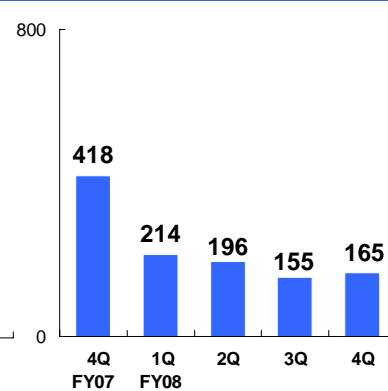
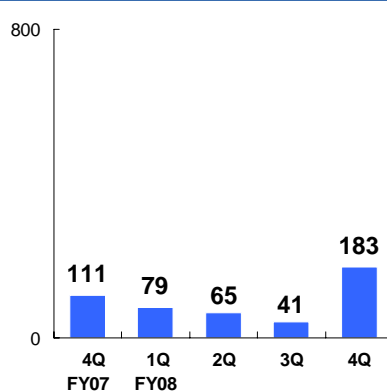
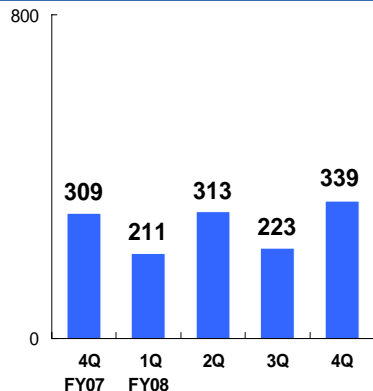
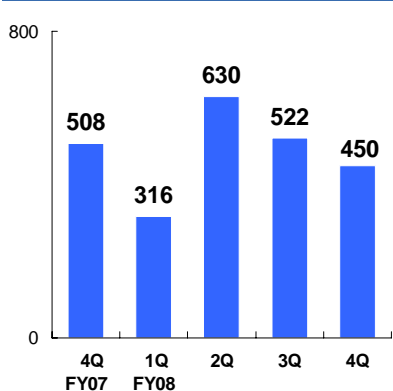
*上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります(FY08/4Q売上高1億円)。



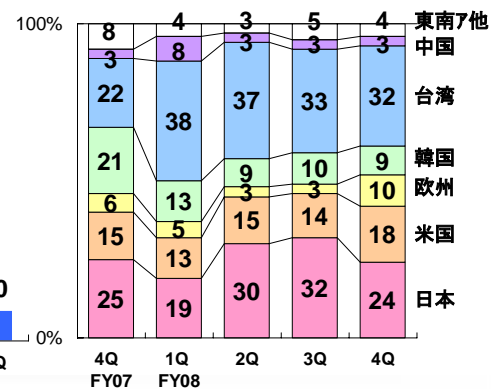
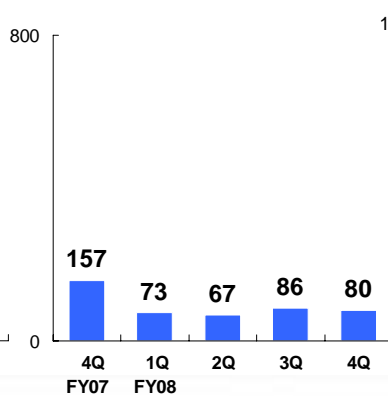
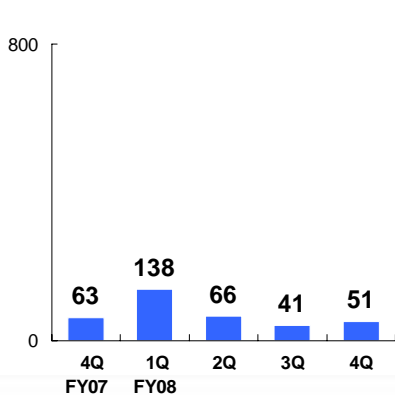
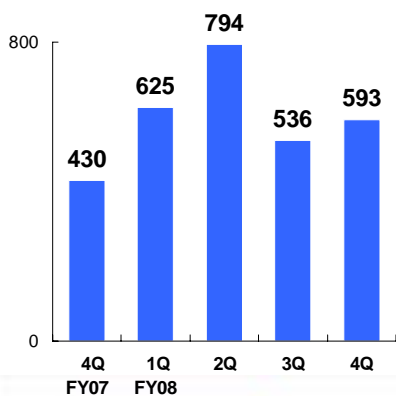
SPE部門地域別売上高

(単位:億円)

日本 米国 欧州 韓国



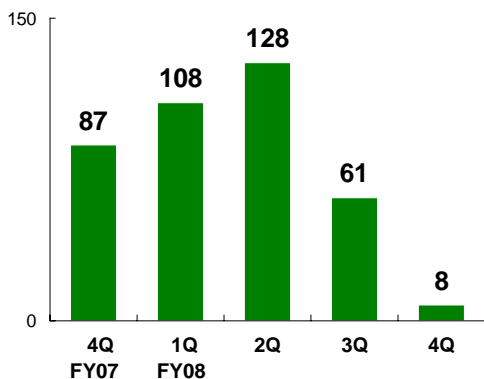
台湾 中国 東南アジア他 地域別構成比



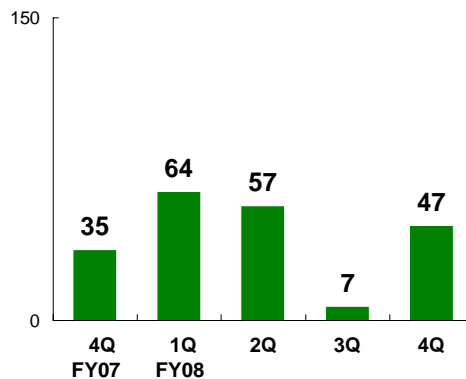
FPD部門地域別売上高

(単位:億円)

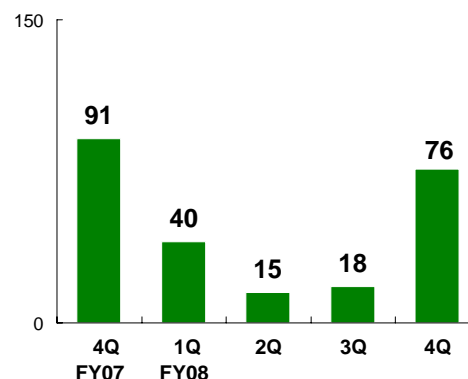
日本



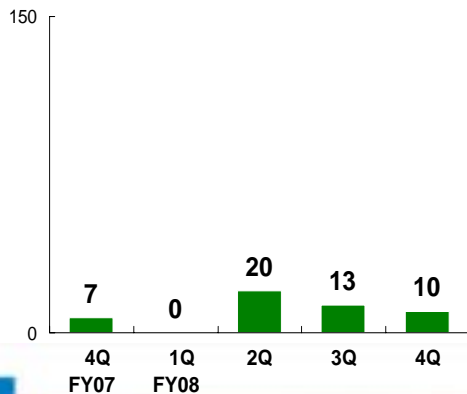
韓国



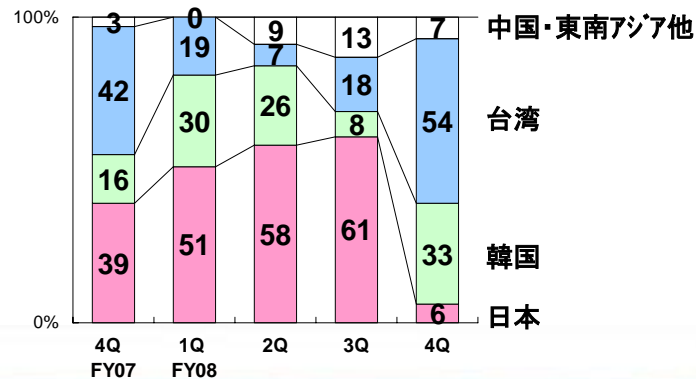
台湾



中国・東南アジア他



地域別構成比



事業の種類別セグメント情報

産業用電子機器

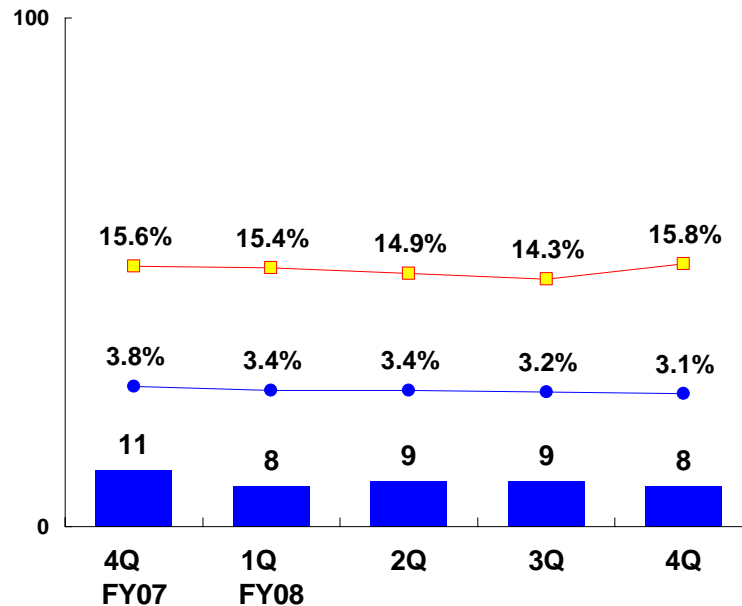
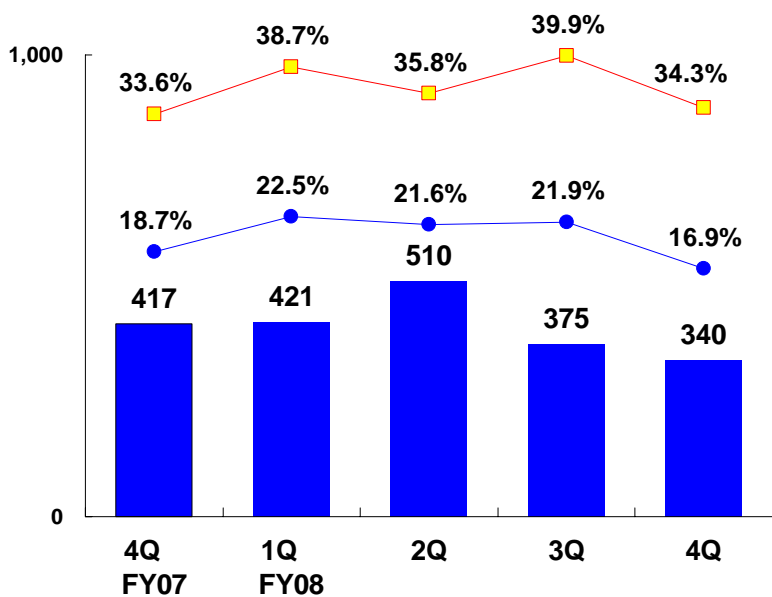
(半導体製造装置、FPD製造装置、その他)

電子部品・情報通信機器

(半導体製品、コンピュータ・ネットワーク機器、ミドルウェア・ソフトウェア、その他電子部品等)

(単位: 億円)

(単位: 億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 □ 売上総利益率

■ 営業利益 ● 営業利益率 □ 売上総利益率

●セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



